

2022-2028年中国物联网芯片行业发展现状调查及 市场规模预测报告

报告大纲

一、报告简介

智研咨询发布的《2022-2028年中国物联网芯片行业发展现状调查及市场规模预测报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chyxx.com/research/202010/901965.html>

报告价格：电子版: 9800元 纸介版：9800元 电子和纸介版: 10000元

订购电话: 010-60343812、010-60343813、400-600-8596、400-700-9383

电子邮箱: sales@chyxx.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

智研咨询发布的《2022-2028年中国物联网芯片行业发展现状调查及市场规模预测报告》共七章。首先介绍了物联网芯片行业市场发展环境、物联网芯片整体运行态势等，接着分析了物联网芯片行业市场运行的现状，然后介绍了物联网芯片市场竞争格局。随后，报告对物联网芯片做了重点企业经营状况分析，最后分析了物联网芯片行业发展趋势与投资预测。您若想对物联网芯片产业有个系统的了解或者想投资物联网芯片行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第1章：物联网芯片行业发展基本概况

1.1 物联网芯片行业定义及分类

1.1.1 物联网芯片行业界定

1.1.2 物联网芯片主流架构

(1) ARM

(2) FPGA

(3) RISC-V

(4) ASIC

1.1.3 物联网芯片产品分类

1.2 物联网芯片行业发展政策环境分析

1.2.1 行业发展监管体系分析

1.2.2 行业发展政策汇总

1.2.3 行业发展规划及解读

1.2.4 行业发展政策趋势展望

1.3 物联网芯片行业发展经济环境分析

1.3.1 全球经济发展分析

1.3.2 中国经济发展分析

1.4 物联网芯片行业发展社会环境分析

1.4.1 “万物互联”已成必然趋势

1.4.2 物联网芯片应用领域不断扩展

1.5 物联网芯片行业发展技术环境分析

1.5.1 行业专利申请情况分析

1.5.2 行业最新技术进展

第2章：全球物联网芯片行业发展分析

2.1 全球物联网芯片行业发展历程

2.2 全球物联网芯片行业发展现状

2.2.1 行业市场需求现状分析

2.2.2 行业企业竞争现状分析

2.2.3 行业典型产品及应用分析

2.3 全球物联网芯片行业重点企业分析

2.3.1 高通

(1) 企业简介

(2) 主营业务及产品

(3) 企业经营业绩

(4) 物联网芯片代表产品及特点

(5) 物联网芯片商用进程及应用领域

2.3.2 恩智浦半导体

(1) 企业简介

(2) 主营业务及产品

(3) 企业经营业绩

(4) 物联网芯片代表产品及特点

(5) 物联网芯片商用进程及应用领域

2.3.3 英特尔

(1) 企业简介

(2) 主营业务及产品

(3) 企业经营业绩

(4) 物联网芯片代表产品及特点

(5) 物联网芯片商用进程及应用领域

2.3.4 英飞凌

(1) 企业简介

(2) 主营业务及产品

(3) 企业经营业绩

(4) 物联网芯片代表产品及特点

(5) 物联网芯片商用进程及应用领域

2.3.5 亚德诺

(1) 企业简介

(2) 主营业务及产品

- (3) 企业经营业绩
- (4) 物联网芯片代表产品及特点
- (5) 物联网芯片商用进程及应用领域
- 2.4 全球物联网芯片行业发展趋势及前景分析
 - 2.4.1 全球物联网芯片行业发展趋势展望
 - 2.4.2 全球物联网芯片行业发展前景预测
- 第3章：中国物联网芯片行业发展分析
 - 3.1 中国物联网芯片行业发展特点分析
 - 3.1.1 企业跨界参与热情高
 - 3.1.2 应用场景针对性强
 - 3.1.3 行业总体发展处于初级阶段
 - 3.1.4 产品定制化需求大
 - 3.2 中国物联网芯片行业发展制约因素
 - 3.2.1 规模效应难以体现
 - 3.2.2 产品安全性要求高
 - 3.2.3 其他制约因素
 - 3.3 中国物联网芯片行业经营分析
 - 3.3.1 中国物联网产业规模分析
 - 3.3.2 物联网芯片行业规模测算
 - 3.3.3 物联网芯片行业盈利性分析
- 第4章：中国物联网芯片行业细分产品市场分析
 - 4.1 安全芯片产品市场分析
 - 4.1.1 产品内涵及外延
 - 4.1.2 产品市场规模
 - 4.1.3 代表产品及企业
 - 4.1.4 产品最新研发动向
 - 4.1.5 产品需求前景分析
 - 4.2 移动支付芯片产品市场分析
 - 4.2.1 产品内涵及外延
 - 4.2.2 产品市场规模
 - 4.2.3 代表产品及企业
 - 4.2.4 产品最新研发动向
 - 4.2.5 产品需求前景分析
 - 4.3 通讯射频芯片产品市场分析
 - 4.3.1 产品内涵及外延

4.3.2 产品市场规模

4.3.3 代表产品及企业

4.3.4 产品最新研发动向

4.3.5 产品需求前景分析

4.4 身份识别类芯片产品市场分析

4.4.1 产品内涵及外延

4.4.2 产品市场规模

4.4.3 代表产品及企业

4.4.4 产品最新研发动向

4.4.5 产品需求前景分析

第5章：中国物联网芯片行业企业竞争分析

5.1 中国物联网芯片行业总体竞争格局

5.1.1 行业主要竞争主体分析

5.1.2 行业竞争层次分析

5.2 中国物联网芯片行业企业国际竞争力分析

5.2.1 行业现有竞争者国际竞争力分析

5.2.2 中国物联网芯片企业国际竞争力趋势判断

5.3 中国物联网芯片行业跨界企业竞争力分析

5.3.1 行业主要跨界参与企业核心竞争力分析

5.3.2 行业主要跨界参与企业竞争力综合分析

第6章：中国物联网芯片行业重点企业分析

6.1 国民技术股份有限公司

6.1.1 企业基本信息

6.1.2 主营业务及产品

6.1.3 企业经营情况分析

6.1.4 物联网芯片代表产品及特点

6.1.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.1.6 企业研发创新能力分析

6.2 大唐微电子技术有限公司

6.2.1 企业基本信息

6.2.2 主营业务及产品

6.2.3 企业经营情况分析

6.2.4 物联网芯片代表产品及特点

6.2.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.2.6 企业研发创新能力分析

6.3 国科微电子股份有限公司

6.3.1 企业基本信息

6.3.2 主营业务及产品

6.3.3 企业经营情况分析

6.3.4 物联网芯片代表产品及特点

6.3.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.3.6 企业研发创新能力分析

6.4 深圳市海思半导体有限公司

6.4.1 企业基本信息

6.4.2 主营业务及产品

6.4.3 企业经营情况分析

6.4.4 物联网芯片代表产品及特点

6.4.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.4.6 企业研发创新能力分析

6.5 深圳市汇顶科技股份有限公司

6.5.1 企业基本信息

6.5.2 主营业务及产品

6.5.3 企业经营情况分析

6.5.4 物联网芯片代表产品及特点

6.5.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.5.6 企业研发创新能力分析

6.6 珠海全志科技股份有限公司

6.6.1 企业基本信息

6.6.2 主营业务及产品

6.6.3 企业经营情况分析

6.6.4 物联网芯片代表产品及特点

6.6.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.6.6 企业研发创新能力分析

6.7 华大半导体有限公司

6.7.1 企业基本信息

6.7.2 主营业务及产品

6.7.3 企业经营情况分析

6.7.4 物联网芯片代表产品及特点

6.7.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.7.6 企业研发创新能力分析

6.8 紫光展锐科技有限公司

6.8.1 企业基本信息

6.8.2 主营业务及产品

6.8.3 企业经营情况分析

6.8.4 物联网芯片代表产品及特点

6.8.5 物联网芯片商用进程及应用领域

6.8.6 企业研发创新能力分析

第7章：中国物联网芯片行业投资前景及策略分析(ZY TL)

7.1 中国物联网芯片行业投资壁垒分析

7.1.1 技术壁垒

7.1.2 资金壁垒

7.1.3 人才壁垒

7.1.4 其他壁垒

7.2 中国物联网芯片行业投资机会剖析

7.2.1 物联网产业发展带来的投资机会

7.2.2 国家政策扶持带来的投资机会

7.2.3 中国经济发展带来的投资机会

7.3 中国物联网芯片行业投资策略分析

7.3.1 行业领先者投资策略建议

7.3.2 行业追赶者投资策略建议

7.3.3 行业跨界者投资策略建议(ZY TL)

图表目录：

图表1：物联网芯片产品分类

图表2：物联网芯片行业产业链简介

图表3：物联网芯片行业主要法律、法规及标准

图表4：物联网芯片行业监管单位及主要职责

图表5：2017-2021年中国GDP增长趋势分析（单位：亿元，%）

图表6：2017-2021年中国城乡居民收入水平（单位：元，%）

图表7：全球物联网芯片发展历程

图表8：2017-2021年中国物联网芯片行业专利申请

图表9：2017-2021年中国原油加工量（单位：元，%）

图表10：2017-2021年高通经营业绩分析

图表11：2017-2021年恩之浦半导体经营业绩分析

图表12：2017-2021年英特尔经营业绩分析

图表13：2017-2021年英飞凌经营业绩分析

图表14：2017-2021年亚德诺经营业绩分析

图表15：2017-2021年中国物联网产业规模分析

图表16：物联网芯片市场需求空间测算

图表17：2017-2021年中国安全芯片市场规模

图表18：2017-2021年中国移动支付芯片市场规模

图表19：2017-2021年中国通讯射频芯片市场规模

图表20：2017-2021年中国身份识别芯片市场规模

图表21：中国物联网芯片主要竞争主体及竞争优势

图表22：国民技术股份有限公司基本信息

图表23：2017-2021年国民技术股份有限公司主要经济指标

图表24：2017-2021年国民技术股份有限公司物联网芯片产品列表

图表25：国民技术股份有限公司经营优劣势分析

图表26：大唐微电子技术有限公司基本信息

图表27：2017-2021年大唐微电子技术有限公司主要经济指标

图表28：2017-2021年大唐微电子技术有限公司物联网芯片产品列表

图表29：大唐微电子技术有限公司经营优劣势分析

图表30：国科微电子股份有限公司基本信息

更多图表见正文.....

详细请访问：<https://www.chyxx.com/research/202010/901965.html>